

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SOLOMON
SYSTECH**

SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED

晶門半導體有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2878)

有關2023年年報的補充公告

茲提述晶門半導體有限公司(「本公司」)於2024年4月26日刊發截至2023年12月31日止年度之年報(「**2023年年報**」)。除文義另有指明者外，本公告所用詞彙與2023年年報所用者具有相同涵義。

董事會就2023年年報提供以下補充資料：

2013年購股權計劃

1. 2013年購股權計劃於2013年5月28日獲採納，並於2023年5月27日屆滿。根據2013年購股權計劃，不得進一步授出購股權。本公司概無其他股份計劃。
2. 截至2023年12月31日止年度，本公司共授出5,900,000份購股權。
3. 於2023年1月1及2023年12月31日，根據計劃授權限額可供授出之購股權數目分別為92,830,235份及0份。2013年購股權計劃項下並無設置任何服務供應商分項限額。
4. 截至2023年12月31日止年度，根據2013年購股權計劃授出的購股權可發行的股份數目為5,900,000股，佔2023年已發行股份加權平均數的0.024%。

5. 於2023年年報日期，已授出之尚未行使購股權總數為29,600,000份，有權認購本公司29,600,000股股份，佔本公司已發行股份總數的1.19%。
6. 截至2023年12月31日止年度，向董事及高級管理層授出的購股權並無附帶任何表現目標。

薪酬委員會已知悉，2013年購股權計劃之目的乃激勵或獎勵承授人對本集團所作出之貢獻且2013年購股權計劃並未就相關貢獻作出嚴格限定。

薪酬委員會亦已考慮下列因素：(a)根據本集團之薪酬慣例，承授人(包括董事)之薪酬包括授出購股權以激勵彼等之工作表現及為本集團之增長及發展作出持續貢獻；(b)各董事之薪酬待遇已由薪酬委員會審閱，以符合行業慣例，並認可彼等就本公司事務管理及策略發展所擔任之領導角色及所承擔之責任；及(c)其他承授人各自之薪酬待遇乃經考慮彼等之行業經驗、任期及於本集團之職務以及對本集團之增長及發展作出之貢獻後釐定。

薪酬委員會於建議授出購股權時，已從定性及定量角度評估承授人對本集團之增長及發展所作貢獻，並考慮多種因素，包括不時之財務及經營目標以及在當前情況下與同行及在業內所作之比較，並將適時進行任何相關評估。

鑒於上文所述，薪酬委員會認為，於截至2023年12月31日止年度向董事及高級管理層授出購股權在並無附帶任何表現目標的情況下具有市場競爭力，並與2013年購股權計劃之目的之一致。

持續關連交易

7. 根據2024年產品銷售及分銷協議(定義見本公司日期為2023年12月5日的通函)，截至2026年12月31日止三個年度各年的持續關連交易的年度上限分別為65百萬美元、75百萬美元及85百萬美元。

上文補充資料並不影響2023年年報所披露的其他資料。除上文所披露者外，2023年年報內的所有其他資料維持不變。

承董事會命
晶門半導體有限公司
公司秘書
余俊敏

香港，2024年8月28日

於本公告刊發日期，董事會由(a)執行董事－王華志先生(行政總裁)；(b)非執行董事－馬玉川先生(主席)、王輝先生及劉斐女士；及(c)獨立非執行董事－陳志光先生、陳正豪博士及郭海成博士組成。